

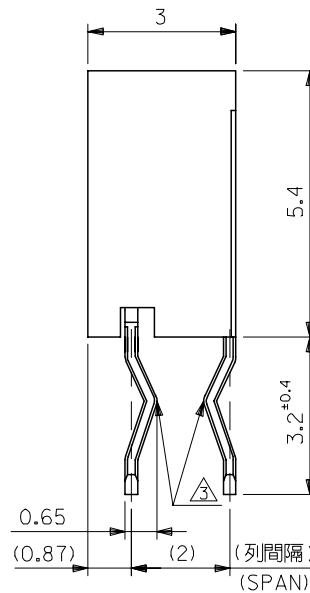
注記 NOTES

- △ 回路番号1を基準に奇数番目の極におけるソルダーテール。
ODD NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- △ 回路番号1を基準に偶数番目の極におけるソルダーテール。
EVEN NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- △ キンフはソルダーテール全極にもうける。
SOLDER TAIL KINK SHALL BE PROVIDED ON ALL TAILS.
- △ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CKT.

5. 使用材料 MATERIAL

- ハウジング : PPS, UL94V-0
- HOUSING
- ターミナル : リン青銅 (t=0.25)
- TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE (t=0.25)
- メッキ : 接点部: 金メッキ : 0.1 MICROMETER MIN.
- PLATING : CONTACT PORTION : GOLD PLATING : 0.1 MICROMETER MIN.
- : 半田付部: 錫メッキ : 1.0 MICROMETER MIN.
- : SOLDERING PORTION : TIN PLATING : 1.0 MICROMETER MIN.
- : 下地: ニッケルメッキ : 1.0 MICROMETER MIN.
- : UNDER PLATING : NICKEL PLATING : 1.0 MICROMETER MIN.

- 6. 本製品は、52806シリーズの金メッキ品である。
THIS PRODUCT IS Au PLATING OF 52806 SERIES.



15	13.05	11	52806-1270	12
8	6.05	4	52806-0570	5
C	B	A	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT
			MODEL NO.	52806-xx70

RELEASED EC NO: J2007-1100 DRWN: MABE1 2006/10/17 CHKD: KTOYODA 2006/10/19 APPR: NUKITA 2007/03/15	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 10:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
	10 UNDER	±0.2	DRAWN BY M. NABE1	DATE '06/10/16	TITLE 1.0 FFC CONN. NON-ZIF DIP ST. -LEAD FREE-		
	10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY K. TOYODA	DATE '06/10/16	MOLEX INCORPORATED		
	30 OVER	±0.3	APPROVED BY N. UKITA	DATE '06/10/16	MATERIAL NO.	DOCUMENT NO. SD-52806-003	SHEET NO. 1 OF 2
	ANGULAR	±3 °	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	

